公司代码:688037　　公司简称:芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为84,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,800,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.41%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司监事会及独立董事已对上述利润分配方案发表同意意见,本次利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯源微	688037	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李凤莉	林顺富
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区 飞云路16号	辽宁省沈阳市浑南区 飞云路16号
电话	024-23806230	024-23826230
电子信箱	688037@kingsemi.com	688037@kingsemi.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机),可用于8/12英寸单晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)及6英寸及以下单晶圆处理(如化合物、MEMS、LED芯片制造等环节)。

@

作为公司标杆产品,光刻工序涂胶显影设备系集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备,主要与光刻机(芯片生产线上最庞大、最精密复杂、难度最大、价格最昂贵的设备)配合进行作业,通过机械手使晶圆在各系统间传输和处理,从而完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。作为光刻机的输入(曝光前光刻胶涂覆)和输出(曝光后图形的显影),涂胶/显影机的性能不仅直接影响到细微曝光图案的形成,其显影工艺的图形质量和缺陷控制对后续诸多工艺(诸如蚀刻、离子注入等)中图形转移的结果也有着深刻的影响。

公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断并填补国内空白,其中,在集成电路前道晶圆加工环节,作为国产化设备已逐步得到验证及应用,实现小批量替代;在集成电路制造后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等环节,作为国内厂商主流机型已广泛应用在国内知名大厂,成功实现进口替代。

公司生产的集成电路前道晶圆加工领域用单片式清洗机Spin Scrubber设备已经达到国际先进水平,在国内多个重要客户处获得批量重复订单,成功实现进口替代。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务,通过向下游公司销售光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品实现收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售,其他业务收入来源于设备相关配件销售及维修服务等。

2、采购模式

公司主要根据生产订单物料、研发物料、售后服务物料的需求计划和安全库存的需要等制定采购计划,采取与供应商单笔合同或签订年度框架合同等方式开展采购。为保证公司产品的质量和性能,公司对供应商进行统一管理,主要考察供应商的资质实力、产品情况、售后服务等方面,经外部供方调查、样品试用或非标准部件定制加工验证通过后确定合格供应商名录,并持续更新及跟踪评级。

3、研发模式

公司以自主研发为主,充分结合产品技术国际发展趋势及客户实际需求,以核心基础技术研究、核心单元零部件研究、整机研发应用并重为原则,确定公司研发方向和研发实施目,建立了机械、电气、软件等多模块协同配合,公司级与部门级研发项目相结合的研发创新机制。同时,公司技术质量部负责对研发项目的立项评审,组织下达设计与开发任务,开展跟踪管理、结项验收评价等具体实施管理。

4、生产模式

公司采用在手订单生产为主、潜在订单预投生产为辅的生产模式。公司根据已签单客户以及有明确需求且供期紧张的潜在客户的具体需求进行产品定制化设计及生产制造,以满足客户对产品不同技术指标和供期要求,同时也能合理控控公司在产品的规模和采滞风险。

5、销售模式

公司主要采取“直销为主、代销为辅”的销售模式。直销模式下,公司通过商务谈判、招投标等方式获取订单;委托代理商销售模式下,公司与特定地区代理商签订产品销售区域代理协议,由其负责在特定地区代理销售公司相关产品,公司向其支付一定比例的代理佣金。

公司配备了专业的销售与服务团队,主要负责售前客户需求分析、商务谈判或招投标环节及销售设备的安装、调试、保修、维修、技术咨询及客户端人员培训等售后工作。公司始终秉承“客户第一,为客户创造价值”的营销理念,致力于为客户提供“专业精品”的产品及服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段、基本特点

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“专用设备制造业”(C35);根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”(C3562)。

公司所处半导体设备行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近年来,为推动半导体产业的发展,进一步促进国民经济持续、快速、健康发展,我国先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《集成电路产业“十三五”发展规划》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策,为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。

随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长,以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展,集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求,为半导体设备行业带来广阔的市场空间。根据SEMI预测报告,2020年半导体设备的全球销售额达到689亿美元,同比增长16%(2019年销售额为598亿美元),创下新纪录。随着全球半导体制造设备市场在2021年和2022年分别达到719亿美元和761亿美元,这一增长有望持续。

前道和后道半导体设备企业都将推动半导体设备的发展。晶圆制造设备企业(包括晶圆加工、工厂设备和掩模/网线设备)销售额预计在2020年增长15%至594亿美元,2021年和2022年预计分别增长4%和6%。代工和逻辑业务占晶圆制造厂设备总销售额的一半左右,在尖端技术投资的推动下,2020年支出将增长15%左右,达到300亿美元。NAND闪存制造设备的支出今年将激增30%,超过140亿美元,而DRAM预计将在2021年和2022年引领增长。中国内地、中国台湾和韩国成为2020年主要消费地区。

(2)主要技术门槛

公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业,涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域,是多门类跨学科知识的综合应用,具有较高的技术门槛,通常是一代器件、一代设备、一代工艺。随着半导体技术的不断进步,芯片特征尺寸不断缩小、硅片尺寸不断扩大、半导体器件的结构趋于复杂,这些技术演进对半导体设备的精度与稳定性提出了更高的要求,未来半导体设备将向高精度化与高集成化方向发展。但与此同时,由于芯片的用途极其广泛,性能要求及技术参数等差异较大,各类性能、用途的芯片大量并存,高、中、低各类技术等级的生产设备均有其对应市场空间,并存发展。

公司所处的半导体设备行业涉及国家基础科学综合实力的比拼,具有技术壁垒高、价值量高、研发周期长等特点。由于半导体工艺流程复杂,对设备依赖度较高,设备性能直接影响半导体制造的产品品质、工艺效率及良率,最终影响到半导体企业的盈利能力和全球竞争力。因此,要想实现中国半导体产业自主可控模式的崛起,完成设备环节的国产化是其至关重要的环节之一。目前,以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业仍占据全球半导体设备市场的主要份额。在需求拉动和国家支持下,我国半导体产业链得以不断完善,但仍然存在供给能力不足的问题,我国半导体市场进口替代存在较大市场空间。伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施,我国半导体设备行业迎来了前所未有的发展契机,半导体设备的国产化进程将不断推进。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒,以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业占据了全球半导体设备市场的主要份额。

目前,集成电路制造前道晶圆加工领域用涂胶显影设备主要被日本东京电子(TEL)所垄断。公司生产的前道涂胶显影设备通过在客户端的验证与改进,在多个关键技术方面取得突破,技术成果已应用到新产品中。报告期内,该类设备陆续获得了上海华力、中芯绍兴、厦门士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯宁波、昆明京东方等多个前道大客户订单及应用。

目前,集成电路制造前道晶圆加工领域用清洗设备主要被日本迪恩士(DNS)等厂商所垄断。通过持续的改进、优化,公司生产的集成电路前道晶圆加工领域用清洗机Spin Scrubber设备的各项指标均得到明显改善或提升,已经达到国际先进水平并成功实现进口替代。该类设备已在中芯国际、上海华力、厦门士兰集科等多个客户处通过工艺验证,并在报告期内获得国内多家Fab厂商的批量重复订单。

公司生产的后道涂胶显影设备与单片式湿法设备,已经从先进封装领域、LED领域拓展到MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域,作为主流机型应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澜湃顺昌、中芯绍兴、中芯宁波等国内一线大厂。报告期内,公司通过借鉴前道产品的先进设计理念和技术,对后道设备、小尺寸设备的架构进行优化,提升了工艺水平和产品产能。应用了前道先进设计理念及技术的后道产品在国内多家封装大厂Fan-out产线应用,目前已经成为客户端的主力量产设备。

截至目前,公司生产的用于集成电路前道晶圆加工领域及后道先进封装、LED、MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域的涂胶显影设备和单片式湿法设备已累计销售1000余台套。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在前道晶圆加工领域,2019年中芯南方12英寸14纳米生产线正式投产,标志着中国大陆集成电路生产工艺向前推进一步,顺利完成《国家集成电路产业发展推进纲要》的目标。根据规划,2020年达到月产能6000片,2021年达到月产能9000片,最终满载达到每月产能35000片的目标;上海华力(华力二期HHFAB6,12英寸)2020年装机月产能达20000片,28纳米有多个新产品顺利量产,14纳米研发在顺利进行中,未来满产可达月产能2万片;2020年长江存储工艺研发继续高歌猛进,4月宣布其128层OLC3DNAND闪存(型号:X2-6070)研发成功,并已在多家控制器厂商SSD等终端存储产品上通过验证。作为业内首款128层OLC规格的3DNAND闪存,长江存储X2-6070拥有业内已知型号产品中最高单位面积存储密度,最高I/O传输速度和最高单颗NAND闪存芯片容量;同时发布128层512GbTLC(3bit/cell)规格闪存芯片(型号:X2-9060),以满足不同应用场景的需求;2020年12月23日,厦门士兰集科微电子有限公司一期正式投产。一期生产线是士兰微旗下第一座12英寸晶圆生产工厂,全部达产后将达到月产能4万片。士兰集科一期厂房采用很多国产设备,其12英寸特色工艺芯片项目总投资170亿元,计划建设两条以MEMS、功率器件为主要产品的12英寸集成电路制造生产线。

在封测产业方面,随着前段先进节点走向10nm、7nm、5nm,研发生产成本持续走高,良率下降,摩尔定律趋缓,半导体行业逐渐步入后摩尔时代。先进封装技术不仅可以增加功能、提升产品价值,还可以有效降低成本,成为延续摩尔定律的关键。其中,SiP(系统级封装)在摩尔定律失效后,或将扛起后摩尔时代电子产品继续向前发展的大旗。在大国博弈的背景下,半导体行业将长期持续国产替代的主题,随着上游的芯片设计公司选择将订单回流到国内,具备竞争力的封测厂商将实质性受益。封测产业作为我国半导体领域优势最为突出的电子行业之一,随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工厂产能利用率的提升,将带来更多的半导体封测新增需求。从全球科技产业周期的角度来看,2020年5G、IoT、服务器、AI等领域带动了存储器、HPC、基频等半导体芯片的需求,封测行业迎来了新一轮的景气周期。

化合物半导体方面,得益于5G建设与新能源汽车不断的发展,市场上对各种高频和高功率应用需求量不断提升,化合物半导体的市场规模不断扩大,相应芯片的设计和制造业务受到越来越多从业者和资本的关注。根据SEMI数据,化合物半导体市场年复合增长率为12.9%,随着5G时代的应用发展,化合物半导体已进入高速发展阶段。2020年,中国大陆超过14个化合物半导体项目及相关产业园区签约落地,总投资额超过800亿元。市场研究公司Yole预测,到2024年,SiC功率半导体市场将以29%的复合年增长率增长,达到20亿美元。近来,GaN晶体管也已被大量用于智能电话和笔记本电脑的充电适配器中。预计到2029年,化合物功率半导体市场将增长五倍以上。

与沿着摩尔定律不断追求晶体管缩小的先进制程不同,特色工艺不完全追求器件的缩小,而是根据不同的物理特性生产不同的产品,包括BCD、CMOS图像传感器、功率器件、IGBT、电源管理芯片、射频器件/无线技术、微机械系统/传感器、嵌入式存储器、新型存储器等。上述特色工艺产品均是物联网、汽车电子等相关应用领域和市场需求的基石,随着汽车电子、AI、5G等的强劲发展,半导体特色工艺市场已迎来爆发式增长,国内代表企业有士兰集团、中芯绍兴、积塔半导体等。

传统LED产业方面,从短周期来看,该行业存在较为明显的周期性特征,自2017年下半年以来,由于上游LED芯片厂商产能持续释放,下游LED需求受国际贸易摩擦和宏观经济放缓等因素的影响出现下滑,LED行业供需失衡导致其步入下行通道,经过近两年的去库存周期,目前,传统LED照明行业产品单价相比前两年已趋于稳定;从中长周期来看,高端产品如Mini/MicroLED、高光效LED、车用LED、紫外/红外LED等新兴应用领域的市场渗透率正逐步提升,到2020年底,MiniLED市场出现大幅增长。未来Mini LED作为新一代背光/显示方案有望快速渗透,市场规模迅速提升,将成为LED芯片制造厂主流的扩产方向。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,224,599,920.37	931,116,076.19	31.52	379,702,816.67
营业收入	328,900,200.07	213,156,650.17	54.30	209,990,524.25
归属于上市公司股东的净利润	48,828,560.81	29,275,895.55	66.79	30,477,913.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,875,142.25	14,932,657.22	-13.78	20,098,187.26
归属于上市公司股东的净资产	798,597,040.69	754,896,927.56	5.79	219,876,928.23
经营活动产生的现金流量净额	-72,389,945.01	12,234,952.89	-691.67	-28,315,546.72
基本每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09	0.48
加权平均净资产收益率(%)	6.31	12.48	减少6.17个百分点	14.80
研发投入占营业收入的比例(%)	13.81	16.45	减少2.64个百分点	16.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,528,919.27	53,926,903.58	149,470,440.07	116,973,937.15
归属于上市公司股东的净利润	-7,869,353.56	14,086,869.84	38,468,558.24	4,142,486.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,688,544.69	-3,699,386.25	29,999,050.27	-2,735,977.08
经营活动产生的现金流量净额	-25,917,505.92	-29,662,163.42	-33,364,823.77	16,554,548.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,969
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,717
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
沈阳先进制造技术产业有限公司	0	14,332,430	17.06	14,332,430	14,332,430	无	0	境内非国有法人
中国科学院沈阳自动化研究所	0	10,500,000	12.50	10,500,000	10,500,000	无	0	国有法人
辽宁科发实业有限公司	0	9,932,820	11.82	9,932,820	9,932,820	无	0	国有法人
中国科技产业投资管理有限公司	-490,254	6,329,746	7.54	0	0	无	0	国有法人
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	0	4,500,000	5.36	0	0	无	0	境内非国有法人
周冰冰	-178,602	4,016,148	4.78	0	0	无	0	境内自然人
宗润福	0	2,650,000	3.15	2,650,000	2,650,000	无	0	境内自然人
国信证券-工商银行-国信证券鼎信6号科创板战略配售集合资产管理计划	0	1,475,750	1.76	0	0	无	0	境内非国有法人
李凤荣	0	1,400,000	1.67	1,400,000	1,400,000	无	0	境内自然人
沈阳科技风险投资有限公司	-293,300	1,206,700	1.44	0	0	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国科技产业投资管理有限公司与国科瑞祺物联网创业投资有限公司存在关联关系,但不存在一致行动关系。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。2020年度,公司实现营业收入32,890.02万元,实现净利润4,882.86万元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相关,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

证券代码:688037　证券简称:芯源微　公告编号:2021-010

沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 每10股派发现金红利2.00元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币48,828,560.81元,期末可供分配利润为人民币59,794,010.72元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为84,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,800,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.41%。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持利润分配总额不变,相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月19日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:“公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,我们同意本次利润分配预案。”

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2021年3月20日

证券代码:688037　证券简称:芯源微　公告编号:2021-011

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称为“公司”)于2021年3月19日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“容诚”)为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与容诚协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月10日

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

首席合伙人:肖厚发

是否营从事证券服务业务:是

历史沿革:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所更名而来,初始成立于2008年12月23日,并于2014年1月16日变更为特殊普通合伙企业,注册地址为沈阳市沈河区北站一路43号1401室,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师860人,较上一年净增375人;全所共有2,800余人从事过证券服务业务,从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

3、业务规模

截至2019年12月31日,容诚会计师事务所净资产为15,336.8万元;2019年度业务收入共计105,772.1万元;承担210家上市公司2019年报审计业务,合计收费25,310.66万元,其资产均值为97.61亿元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业,文体娱乐、金融证券等多个行业。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元;建立了较为完备的质量控制体系,目成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年,容诚会计师事务所无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:吴宇,中国注册会计师,澳大利亚注册会计师,财政部全国会计领军人才,全国注册会计师行业五四奖章获得者。1995年开始从事审计工作,拥有25年的证券服务业务工作经验,1996年至今任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、业务总监、合伙人。曾为机器人(300024)、辽宁成大(600739)、聚龙股份(300202)、芯源微(688037)、蔚蓝股份(002667)、锌业股份(000751)、莱茵体育(000558)、智云股份(300897)、楚江港(600317)、锦州港(600190)、经纬潮绘(838010)、东邦环保(872636)、金印传媒(871470)、港峰股份(870496)、辽宁中科(872680)、辽宁文投(832647)、辽宁天丰(834123)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

拟任质量控制复核人:宫颖,中国注册会计师,2010年开始从事审计业务,2016年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经验,无兼职。

拟签字会计师:冯颖,中国注册会计师,自1996年起一直从事审计工作,曾为聚龙股份有限公司(300202)、凌源钢铁股份有限公司(600231)、沈阳芯源微电子设备股份有限公司(688037)、葫芦岛锌业股份有限公司(000751)、鞍山森远路桥股份有限公司(300210)等上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

拟签字会计师:董博佳,中国注册会计师,自2015年起一直从事审计工作,曾为英茵达体育发展股份有限公司(000558)、沈阳芯源微电子设备股份有限公司(688037)、福鞍控股有限公司(000601)、鸡西市国有资产经营管理有限公司、阜新高新技术开发建设有限责任公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司(830852)等上市公司、IPO企业、发债企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020年度,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计、内部控制审计费用共60万元(含税)。

关于2021年度审计费用,公司拟提请股东大会授权管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)独立董事发表意见

公司独立董事对公司聘请的审计机构容诚进行了审查,发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力,能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司2021年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形,我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。综上,我们同意《关于续聘2021年度审计机构的议案》,并提交公司股东大会审议。”具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)董事会审计委员会审议续聘会计师事务所情况

2021年3月19日,公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意继续聘请容诚为公司2021年度审计机构。

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚进行了审查,认为容诚参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘容诚为公司2021年度审计机构。

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

2021年3月19日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意继续聘请容诚为公司2021年度审计机构。

(四)监事会审议续聘会计师事务所情况

2021年3月19日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意继续聘请容诚为公司2021年度审计机构。

(五)本次关于续聘容诚为公司2021年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

(一)沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见;

(二)沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2021年3月20日

证券代码:688037　证券简称:芯源微　公告编号:2021-012

沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2335号)同意注册,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)21,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币26.97元,应募集资金总额为566,370,000.00元,根据有关规定扣除发行费用60,625,896.22元后,实际募集资金净额为505,744,103.78元。以上募集资金已于2019年12月10日到位,募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具会验字[2019]8294号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

2020年度,本公司募集资金使用情况为:(1)直接使用超募资金支付发行费用(不含增值税)4,096,226.41元;(2)对募集资金项目投入107,866,768.64元,其中:高端晶圆产业化项目45,723,696.72元,高端晶圆研发中心项目62,143,071.92元;(3)使用超募资金永久补充流动资金38,300,000.00元;(4)使用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元。2020年度公司累计使用募集资金230,262,995.05元,支付银行手续费(不含增值税)5,423.05元,募集资金专用账户利息收入为3,234,204.80元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益10,813,328.33元,募集资金专用账户2020年12月31日余额合计为293,675,298.68元。具体明细如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金净额	505,744,103.78
减:截至2020年末公司直接对募集资金项目投入	107,866,768.64
其中:高端晶圆处理设备产业化项目	45,723,696.72
高端晶圆处理设备研发中心项目	62,143,071.92
减:截至2020年末公司使用超募资金永久补充流动资金	38,300,000.00
减:截至2020年末公司使用超募资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
加:截至2020年末公司募集资金理财收益	10,813,328.33
加:截至2020年末公司募集资金利息收入扣除手续费净额	3,284,635.21
募集资金余额	293,675,298.68

二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,于2019年4月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定(募集资金管理办法)的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2019年12月11日,公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。公司于2019年12月11日在中信银行沈阳和平支行开设募集资金专项账户(账号8112901012900643057),于2019年12月11日在中国建设银行沈阳城内支行开设募集资金专项账户(账号21050139000800001256),于2019年12月11日在招商银行沈阳浑南西路支行开设募集资金专项账户(账号124904600110111)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。截至2020年12月31日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2020年12月31日,募集资金专项账户余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行沈阳和平支行	8112901012900643057	80,853,134.46
中国建设银行沈阳城内支行	21050139000800001255	200,614,695.21
招商银行沈阳浑南西路支行	124904600110111	12,207,469.01
合　计		293,675,298.68

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2